

2026年3月27日から4月2日までの1週間における、半導体、AI、およびテック産業の主要ニュースをカテゴリ別にまとめました。

1. 次世代プロセッサとAI設計技術の進化

次世代の計算能力向上に向けたハードウェアとソフトウェアの進展が目立ちました。

- **AMDの次世代サーバーCPU「Zen 6」**: コードネーム「Venice」のエンジニアリングサンプルが確認され、最大**192コア**、**1CCDあたり32コア**という高密度な構成が明らかになりました。
- **AIによるチップ設計の自動化**: スタートアップの**Cognichip**が、AIを活用して半導体設計を効率化するプラットフォーム開発のために**6,000万ドル**を調達しました。開発コストを**75%以上削減**できるとしています。
- **NvidiaとIntelの性能向上技術**: NvidiaはRTX 50シリーズ向けに、フレーム生成を**5～6倍に拡大するDLSS 4.5**のベータ版を公開しました。一方、Intelは「iBOT」技術によりGeekbenchスコアが最大**30%向上**することが確認されています。

2. 巨大資本の流入と市場再編

AIへの期待を背景に、異例の規模の資金調達や投資が行われています。

- **OpenAIの巨額調達**: Amazon、Nvidia、ソフトバンクなどが主導するラウンドで**1,220億ドル**(約**18兆円**)を調達し、企業評価額は**8,520億ドル**に達しました。
- **Nvidiaによる戦略的投資**: Nvidiaは、カスタムAIチップの相互接続技術を強化するため、競合でもある**Marvell**に**20億ドル**を投資しました。
- **欧州のAIインフラ自立**: フランスの**Mistral AI**が、パリ近郊のデータセンター建設に向け**8億3,000万ドル**の債務調達を実施し、米国企業への依存脱却を図っています。

3. 地政学的リスクと国家間の攻防

半導体技術をめぐる安全保障と市場シェアの変化が鮮明になっています。

- **中国市場での変化**: 中国政府による国産チップ推進の影響で、**Nvidia**の中国市場シェアが**60%未満**に低下しました。一方で、中国の業界リーダーは、AIデータセンター向けチップで米国に**5～10年の遅れ**があることを認めています。
- **産業スパイと安全保障**: **TSMC**の**2nm**技術情報を盗んだ元エンジニアに対し、台湾国家安全法が適用され、最大**20年の禁錮刑**が科される可能性がある裁判が注目を集めています。また、イランがNvidiaやMicrosoftなど米国テック企業**17社**に対し、施設破壊の脅迫を行いました。
- **日本の国産チップ計画**: 富士通が**Rapidus**と連携し、**1.4nm**プロセスの**AIチップ**を国内で設計・製造する計画を発表しました。

4. データセンターと物理的リソースの課題

AI需要の爆発的な拡大が、電力や材料、人材に大きな負荷をかけています。

- 電力確保とエネルギー問題: Metaの大規模AIデータセンター「Hyperion」は、電力を賄うために10基の天然ガス発電所を新設する予定です。また、オラクルはAI投資資金を捻出するために1万人規模のレイオフを実施しました。
- 供給リスク: 半導体製造に不可欠なヘリウムの世界的供給不足が、サプライチェーンへの深刻な脅威となっています。
- 新たなフロンティア: 地上の制約を回避するため、宇宙空間にデータセンターを構築するStarcloudが1億7,000万ドルを調達し、YC史上最速でユニコーン企業となりました。

5. 消費者向け市場とユニークな技術トピック

- 大幅セール: RTX 5090を搭載したHP製ゲーミングPCが1,500ドル引きされるなど、ハイエンド製品の価格競争が見られました。
- AIを活用した改造: 改造愛好家がClaude AIを用いてBIOSを編集し、本来マザーボードと互換性のないIntelのOEM専用CPUを起動させることに成功しました。
- レトロな周辺機器: フロッピーディスクの外観を模した、最大1,200MB/sの高速転送が可能なM.2 SSDエンクロージャーが登場しました。

対象期間: 2026年03月27日 ~ 2026年04月02日

カバレッジ: Reuters / Bloomberg / The Information / Tom's Hardware / TechCrunch / SemiAnalysis

トピック: 半導体産業・関税政策・CHIPS法

=====

■ 2026年03月30日 のニュース

【Layer 2 | アーキテクチャとAI設計】

★★☆ ScaleOps、AIインフラ効率化へ1億3000万ドル調達

出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/scaleops-130m-series-c-kubernetes-efficiency-ai-demand-funding/>

ScaleOpsはGPU不足とAIクラウドコストの急騰に対応するため、1億3000万ドルの資金調達を実施した。同社はリアルタイムでインフラを自動最適化するソリューションを提供し、AI需要拡大に伴うコンピューティングリソースの非効率を解消することを目指す。GPU不足が深刻化する中、ハードウェア増強ではなくソフトウェアによる効率化アプローチで市場に切り込む戦略を取っている。

 調達額: 1億3000万ドル(\$130M)

 ScaleOps


★★★ AMD Zen 6「Venice」ES品が最大192コア・CCD32コアで判明、新プラットフォームも流出

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-zen-6-venice-es-chips-break-cover-with-up-to-192-cores-32-per-ccd-in-early-stress-test-kenya-congo-nigeria-platforms-leaked>

AMDの次世代サーバー向けCPUアーキテクチャ「Zen 6」コードネーム「Venice」のエンジニアリングサンプル(ES)が早期ストレステストで姿を現した。最大192コアを搭載し、1CCDあたり32コアという構成が確認された。また、Kenya・Congo・Nigeriaと名付けられた新プラットフォームの情報も流出しており、EPYC Turinの後継となる次世代EPYCラインアップの詳細が明らかになりつつある。データセンター・AI向けサーバー市場における競争力強化が期待される。

 最大192コア、1CCDあたり32コア

 AMD, EPYC


★☆☆ レノボThinkPad X1 2-in-1 Gen 10が1,100ドル引きのセール

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/laptops/grab-usd1-100-off-lenovos-ultimate-2-in-1-oled-road-warrior-two-devices-for-one-single-price>

レノボのThinkPad X1 2-in-1 Gen 10(Intel製、14インチ、Aura Edition)がTom's Hardwareで紹介されている。OLEDディスプレイを搭載したビジネス向けプレミアム2-in-1ノートPCで、1,100ドルの割引セールが実施中。タブレットとノートPCを兼ねる「2台分1台」のコンセプト製品。半導体産業への直接的な技術的影響は限定的で、消費者向けPC市場の製品情報記事に該当する。

 割引額: 1,100ドル、画面サイズ: 14インチ、世代: Gen 10

 レノボ, Intel, ThinkPad


★☆☆ Intel Arrow Lake RefreshとZ890マザーボードのバンドル特価: 800ドル以下でビルド開始


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/just-usd151-for-32gb-of-corsair-vengeance-ddr5-6400-ram-when-bundled-with-intels-new-270k-plus-and-z890-e-motherboard-start-your-arrow-lake-refresh-build-for-less-than-usd800>

CorsairのDDR5-6400 32GBメモリが151ドル、IntelのCore Ultra 200K(Arrow Lake Refresh)とASUSのZ890-Eマザーボードとのバンドル購入で800ドル以下のPC構成が実現可能というセール情報記事。最新世代プラットフォームへの移行コストを下げるプロモーション案件で、消費者向けPC市場における価格競争と需要喚起を反映している。

 DDR5-6400 32GB: \$151、システム総額: \$800以下、対象CPU: Intel Core Ultra 270K(Arrow Lake Refresh)、マザーボード: Z890-E

 Intel, Corsair, ASUS, Tom's Hardware

【Layer 3 | 物理的資源とインフラ】


★★★ Mistral AI、パリ近郊データセンター建設に向け8億3000万ドルの債務調達


出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/mistral-ai-raises-830m-in-debt-to-set-up-a-data-center-near-paris/>

フランスのAIスタートアップMistral AIが、パリ近郊にデータセンターを建設するため8億3000万ドル(約1200億円)の債務調達を実施した。同データセンターは2026年第2四半期の稼働開始を目指しており、欧州におけるAIインフラの自立化・強化を図る動きとして注目される。米国Big Tech依存からの脱却を志向する欧州AI戦略の一環とも位置づけられる。

 調達額8億3000万ドル、稼働目標2026年Q2

 Mistral AI, フランス, パリ


★★☆ Starcloud、宇宙データセンター構築に向け1億7000万ドルのシリーズA調達


出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/starcloud-raises-170-million-series-a-to-build-data-centers-in-space/>

宇宙空間にデータセンターを構築するスタートアップStarcloudが、シリーズAラウンドで1億7000万ドルの資金調達に成功した。同社はYコンビネーター出身で、デモデーからわずか17ヶ月でユニコーン企業となり、YC史上最速のユニコーン到達記録を樹立した。宇宙インフラという新たな半導体・AI計算資源の領域への巨大資本流入を示す注目事例。

 調達額1億7000万ドル(シリーズA)、YCデモデーからユニコーン到達まで17ヶ月

 Starcloud, Y Combinator


★★☆ イーロン・マスクのTeraFab構想: テスラ・SpaceXの垂直統合への一歩か、それとも非現実的な夢か?

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/analyzing-elon-musk-terafab-a-step-towards-tesla-and-spacexs-partial-vertical-integration-or-an-unattainable-dream>

イーロン・マスクが提唱するTeraFab構想は、テスラやSpaceX向けに半導体を内製化する自社ファブの建設計画。TSMCなど外部ファンドリへの依存を減らし部分的な垂直統合を目指すと考えられるが、半導体製造の技術的・資本的障壁の高さから実現可能性に疑問符がつく。記事はTSMCのファブ画像を参照しつつ、マスクの野心的戦略を分析している。

 記事本文に具体的数字の記載なし

 Elon Musk, Tesla, SpaceX, TSMC, TeraFab

【Layer 4 | 地政学と巨大資本】


★★★ TSMC産業スパイ事件、来月判決へ——2nm技術情報窃取で元エンジニアが最大20年の刑事リスク


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-industrial-espionage-saga-heading-to-verdict-next-month-in-unprecedented-taiwan-national-security-act-case-former-engineer-accused-of-stealing-2nm-technical-info-faces-a-total-of-up-to-20-years-in-prison-if-found-guilty>

台湾積体回路製造 (TSMC) の機密技術情報を窃取したとして起訴された元エンジニアの裁判が、来月判決を迎える。台湾の国家安全保障法が適用された前例のないケースで、被告は最先端の2nmプロセス技術に関する情報を盗んだとされ、有罪の場合、最大20年の禁錮刑が科される可能性がある。半導体技術をめぐる産業スパイ事案として台湾の安全保障法制が問われる重要な司法判断となる。

 最大20年の禁錮刑、2nmプロセス技術

 TSMC, 台湾, 台湾国家安全保障局


★★★ 中国チップ業界リーダーが認める: AIデータセンター向け半導体で5~10年の遅れ


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/chinese-chip-industry-leaders-say-ai-demand-is-straining-equipment-and-talent-supply>

中国の半導体業界の指導者たちが、AIデータセンター向けチップにおいて米国など先進国に対し5~10年の技術的遅れがあることを公式に認めた。AI需要の急増により、製造装置および技術人材の供給が逼迫しており、中国の半導体産業の追い上げを一層困難にしている。輸出規制や技術封鎖を背景に、自国での能力構築を目指す中国が直面する構造的課題が浮き彫りになった。

 5~10年(技術的遅れの推定年数)

 中国, 米国, Tom's Hardware

【Layer 5 | 市場再編と国家連合】


★★★ AIチップ新興企業Rebellions、IPO前に23億ドル評価額で4億ドル調達

出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/ai-chip-startup-rebellions-raises-400-million-at-2-3b-valuation-in-pre-ipo-round/>

韓国発AIチップスタートアップのRebellionsが、IPO前ラウンドで4億ドルの資金調達に成功し、企業評価額は23億ドルに達した。同社はAI推論処理に特化したチップを設計しており、Nvidiaの市場支配に挑む競合として注目されている。今年後半の株式上場を計画しており、AI半導体市場における新たなプレーヤーとして存在感を高めている。

 調達額4億ドル、企業評価額23億ドル(2.3B USD)

 Rebellions, Nvidia

☆☆☆ RTX 5090搭載HP製ゲーミングPC、GPU単体と同価格で1500ドル割引セール中

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/desktops/gaming-pcs/score-an-entire-rtx-5090-gaming-pc-for-the-same-price-as-the-gpu-itself-thanks-to-a-massive-usd1-500-off-epic-hp-pre-built-is-ready-for-4k-gaming-with-32gb-ddr5-ram-and-a-1tb-ssd>

HP Omen Max 45LゲーミングPCがRTX 5090を搭載しながらGPU単体価格と同等で購入可能なセールが実施中。32GB DDR5 RAMと1TB SSDを備え4Kゲーミングに対応する完成品PCが

1500ドル割引となっており、コストパフォーマンスの高い選択肢として注目されている。半導体産業への直接的な技術的インパクトは低いが、消費者向けGPU市場の価格動向を反映している。

 割引額: 1500ドル、RAM: 32GB DDR5、ストレージ: 1TB SSD

 HP, NVIDIA, Tom's Hardware

■ 2026年03月30日 のニュース

【Layer 2 | アーキテクチャとAI設計】


★★☆ ScaleOps、AIインフラ自動化で1億3000万ドル調達


出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/scaleops-130m-series-c-kubernetes-efficiency-ai-demand-funding/>

ScaleOpsはGPU不足とAIクラウドコストの高騰に対応するため、インフラをリアルタイムで自動最適化するソリューションを提供し、1億3000万ドルの資金調達に成功した。AI需要の急増に伴うコンピューティング資源の効率化ニーズに応える形で、クラウドインフラの自動管理により運用コスト削減と資源利用効率の向上を目指している。

 調達額: 1億3000万ドル (130M USD)

 ScaleOps


★★☆ AIチップスタートアップRebellions、23億ドル評価額でIPO前資金調達4億ドル

出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/ai-chip-startup-rebellions-raises-400-million-at-2-3b-valuation-in-pre-ipo-round/>

AIチップ設計スタートアップのRebellionsが、プレIPOラウンドで4億ドルの資金調達に成功し、企業評価額は23億ドルに達した。同社はAI推論処理に特化したチップを設計しており、今年後半の上場を計画している。NvidiaのAIチップ市場支配に挑む競合企業の一つとして注目される。

 調達額4億ドル、企業評価額23億ドル (2.3B USD)

 Rebellions, Nvidia



★★★ AMD Zen 6「Venice」ES版チップが最大192コア・CCD当たり32コアで登場

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-zen-6-venice-es-chips-break-cover-with-up-to-192-cores-32-per-ccd-in-early-stress-test-kenya-congo-nigeria-platforms-leaked>

AMDの次世代サーバー向けCPUアーキテクチャ「Zen 6」コードネーム「Venice」のエンジニアリングサンプル (ES) チップが初めて姿を現した。最大192コアを搭載し、1つのCCD (Core Chiplet Die) 当たり32コアという大幅な密度向上を実現。また「Kenya」「Congo」「Nigeria」といった新プラットフォーム名もリークされており、EPYC Turinの後継として次世代データセンター市場への本格展開が見込まれる。

 最大192コア、CCD当たり32コア
 AMD, EPYC


★☆☆ レノボ ThinkPad X1 2-in-1 Gen10 OLEDが1,100ドル割引


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/laptops/grab-usd1-100-off-lenovos-ultimate-2-in-1-oled-road-warrior-two-devices-for-one-single-price>

レノボのThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Intel 14インチ Aura Editionが1,100ドル割引で販売中。OLEDディスプレイを搭載した2-in-1コンバーティブル型ノートPCで、ビジネス向けモバイルデバイスとして1台2役を実現。半導体技術の観点では、インテルチップを搭載した最新世代の製品であり、消費者向けPC市場における高付加価値製品の販売動向を示す記事。

 割引額: \$1,100、画面サイズ: 14インチ、世代: Gen 10

 Lenovo, Intel, ThinkPad

★☆☆ Intel Arrow Lake RefreshとZ890マザーボードのバンドル特価: 800ドル以下でビルド開始

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/just-usd151-for-32gb-of-corsair-vengeance-ddr5-6400-ram-when-bundled-with-intels-new-270k-plus-and-z890-e-motherboard-start-your-arrow-lake-refresh-build-for-less-than-usd800>

CorsairのDDR5-6400 32GBメモリが151ドル、IntelのCore Ultra 200K系新CPU(270K Plus)とASUSのZ890-Eマザーボードとのバンドル購入で800ドル以下のシステム構築が可能というセール情報。Arrow Lake Refreshプラットフォームへの移行コストを抑えたいユーザー向けのコスパ重視の特価案内記事。

 DDR5-6400 32GB: \$151、システム合計: \$800以下、CPU: Core Ultra 270K Plus

 Intel, Corsair, ASUS, Tom's Hardware


★☆☆ RTX 5090搭載HP製ゲーミングPC、GPU単体と同価格で購入可能に——1,500ドル引きの大幅値引き

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/desktops/gaming-pcs/score-an-entire-rtx-5090-gaming-pc-for-the-same-price-as-the-gpu-itself-thanks-to-a-massive-usd1-500-off-epic-hp-pre-built-is-ready-for-4k-gaming-with-32gb-ddr5-ram-and-a-1tb-ssd>

HP Omen Max 45LゲーミングPCがGPU単体(RTX 5090)と同等価格で購入できるセールが実施されている。32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、4Kゲーミングに対応。1,500ドルの大幅値引きにより、高性能プリビルドPCが割安で入手可能となった。消費者向けゲーミング市場における価格競争の一端を示す話題。

 1,500ドル引き、32GB DDR5 RAM、1TB SSD、RTX 5090

 HP, NVIDIA, Tom's Hardware

【Layer 3 | 物理的資源とインフラ】


★★★ Mistral AI、パリ近郊データセンター建設に8億3000万ドルの負債調達

出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/mistral-ai-raises-830m-in-debt-to-set-up-a-data-center-near-paris/>

フランスのAIスタートアップMistral AIが、パリ近郊にデータセンターを建設するため8億3000万ドル(約1,250億円)の負債調達を実施した。同社は2026年第2四半期までにデータセンターの稼働開始を目指している。欧州のAI自立性強化を狙った大規模インフラ投資であり、米国Big Techへの依存脱却を図るフランス・欧州戦略の一環とも捉えられる。

 調達額8億3000万ドル(負債)、稼働目標2026年Q2

 Mistral AI, フランス, パリ, 欧州


★★☆ Starcloud、宇宙データセンター構築に向けシリーズA1億7000万ドル調達


出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/starcloud-raises-170-million-series-a-to-build-data-centers-in-space/>

スタートアップ企業Starcloudが宇宙空間にデータセンターを構築する計画のもと、シリーズAラウンドで1億7000万ドルの資金調達に成功。YCombinator出身の同社はデモデイからわずか17ヶ月でユニコーン企業に到達し、最速記録を更新した。宇宙インフラという新たな物理的計算資源の確保を目指す動きとして注目される。

 調達額1億7000万ドル(シリーズA)、ユニコーン到達まで17ヶ月

 Starcloud, Y Combinator

★★☆ マスクのTeraFab構想: テスラ・SpaceXの垂直統合への一歩か、実現不可能な夢か

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/analyzing-elon-musks-terafab-a-step-towards-tesla-and-spacexs-partial-vertical-integration-or-an-unattainable-dream>

イーロン・マスクが構想するTeraFabは、テスラやSpaceX向けに半導体を自社製造する垂直統合戦略の一環とされる。TSMCなど既存ファウンドリへの依存脱却を目指すものだが、半導体製造には莫大な設備投資・技術力・サプライチェーン構築が必要であり、その実現可能性には大きな疑問符が付く。記事はTSMCのファブ画像を引用しつつ、構想の野心と現実のギャップを分析している。

 記事本文に具体的数字の記載なし

 Elon Musk, Tesla, SpaceX, TSMC, TeraFab

【Layer 4 | 地政学と巨大資本】

★★★ TSMC産業スパイ事件、来月判決へ——台湾安全保障法の前例なき裁判


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30


URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-industrial-espionage-saga-heading-to-verdict-next-month-in-unprecedented-taiwan-national-security-act-case-former->

engineer-accused-of-stealing-2nm-technical-info-faces-a-total-of-up-to-20-years-in-prison-if-found-guilty

TSMCの2nm技術情報を盗んだとして起訴された元エンジニアの裁判が来月判決を迎える。台湾国家安全法が適用される前例のない事件で、有罪の場合最大20年の禁固刑が科される可能性がある。先端半導体プロセスの知的財産保護と経済安全保障の観点から業界全体に大きな影響を与える注目案件。

 最大20年の禁固刑、2nmプロセス技術

 TSMC, 台湾, 台湾国家安全保障局


★★★ 中国チップ業界リーダーがAIデータセンター用チップで5～10年の遅れを認める


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/chinese-chip-industry-leaders-say-ai-demand-is-straining-equipment-and-talent-supply>

中国の半導体業界の指導者たちが、AIデータセンター向けチップにおいて米国に対し5～10年の技術的遅れがあることを公式に認めた。AI需要の急拡大により、製造装置や技術人材の供給が逼迫しており、中国国内のキャパシティ不足が深刻化している。輸出規制による先端装置へのアクセス制限も相まって、中国のAIチップ自給自足への道のりは依然として険しい状況にある。

 5～10年(技術的遅れの推定期間)

 中国, 米国, Tom's Hardware

■ 2026年03月31日 のニュース

【Layer 2 | アーキテクチャとAI設計】


★★☆ ScaleOps、AIインフラ効率化へ1億3000万ドル調達


出典: TechCrunch | 2026-03-30

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/30/scaleops-130m-series-c-kubernetes-efficiency-ai-demand-funding/>

ScaleOpsはGPU不足とAIクラウドコストの高騰に対応するため、リアルタイムでインフラを自動最適化するソリューションを提供し、1億3000万ドルの資金調達を実施した。AI需要の急増により半導体リソースの効率的な活用が急務となる中、コンピューティング効率の改善を通じてクラウドコスト削減と資源最適化を目指す。

 調達額: 1億3000万ドル(\$130M)

 ScaleOps

★★☆ 改造者がAI支援でIntelのOEM専用CPU「Bartlett Lake」を一般向けマザーボードで起動に成功


出典: Tom's Hardware | 2026-03-31


URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/modder-gets-intels-oem-only-bartlett-la>

ke-cpu-to-post-on-a-regular-asus-z790-motherboard-bios-was-edited-by-claude-ai-to-make-core-ultra-9-273qpe-boot

改造愛好家がIntelのOEM専用CPU「Core Ultra 9 273QPE (Bartlett Lake)」を、一般消費者向けのAsus Z790マザーボードで起動させることに成功した。Claude AIを活用してBIOSを編集・改造することで実現。本来OEMメーカー向けに限定供給されるCPUを、市販マザーボードで動作させた技術的事例であり、IntelのCPUアーキテクチャとBIOS互換性の仕組みを浮き彫りにした。

 Core Ultra 9 273QPE、Z790(マザーボードプラットフォーム)

 Intel, Asus, Claude AI, Anthropic

★☆☆ フロッピーディスク型SSDエンクロージャーが28ドルで登場、最大1,200MB/sの高速転送に対応

出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/this-usd28-floppy-disk-ssd-enclosure-is-a-fun-and-fast-way-to-keep-your-storage-safe-both-practical-and-nostalgic-this-rugged-usb-c-aluminum-enclosure-for-m-2-drives-supports-speeds-of-up-to-1-200-mb-s>

HagibisがフロッピーディスクをモチーフにしたM.2 SSD用アルミニウム製エンクロージャーを28ドルで販売。USB-C接続で最大1,200MB/sの転送速度をサポートし、実用性とノスタルジーを兼ね備えたユニークな製品。頑丈な設計でストレージの保護にも適しており、レトロデザインと現代の高速ストレージ技術を融合させた周辺機器として注目される。

 価格: 28ドル、最大転送速度: 1,200MB/s

 Hagibis, Tom's Hardware


★★★ AMD Zen 6「Venice」ESチップが判明、最大192コア・CCD当たり32コアを確認

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-zen-6-venice-es-chips-break-cover-with-up-to-192-cores-32-per-ccd-in-early-stress-test-kenya-congo-nigeria-platforms-leaked>

AMDの次世代サーバー向けCPUアーキテクチャ「Zen 6」コードネーム「Venice」のエンジニアリングサンプル(ES)チップが明らかになった。最大192コアを搭載し、1つのCCD(コアチップレット)当たり32コアを実現する。現行EPYC Turinの後継となる本製品は、Kenya・Congo・Nigeriaというプラットフォームの存在もリークされており、AMDがデータセンター市場での競争力強化を図る次世代製品の詳細が徐々に明らかになっている。

 最大192コア、CCD当たり32コア

 AMD, EPYC, Tom's Hardware

【Layer 3 | 物理的資源とインフラ】


★★☆ ビットコインネットワークのハッシュレートが2020年以来初の四半期下落——イラン紛争でマイナーがAIインフラへの転換を加速

出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/cryptomining/iran-conflict-forces-bitcoin-mining-operators-to-pivot-to-ai-infrastructure-btc-network-sees-the-first-quarterly-hashrate-drop-since-2020>

ビットコインネットワークのハッシュレートが2020年以来初めて四半期ベースで下落した。イランの地政学的リスクの高まりが、同地域のビットコインマイニング事業者に影響を与えており、マイニング事業者がそのコンピューティングインフラをAI処理向けに転換する動きを加速させている。半導体・GPU資源の配分がマイニングからAIワークロードへとシフトする業界トレンドが鮮明になっている。

 2020年以来初の四半期ハッシュレート下落

 Iran (イラン), Bitcoin network (ビットコインネットワーク)


★★☆ マスクのTeraFab構想：テスラ・SpaceXの垂直統合への一歩か、それとも実現不可能な夢か

出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/analyzing-elon-musks-terafab-a-step-towards-tesla-and-spacexs-partial-vertical-integration-or-an-unattainable-dream>

イーロン・マスクが提唱するTeraFab構想は、テスラやSpaceX向けに半導体製造を内製化する垂直統合戦略の一環として注目される。TSMCなどの既存ファウンドリへの依存を減らし、自社チップ製造能力を持つことを目指すが、巨大な設備投資・技術的障壁・人材確保など課題は多く、実現可能性については懐疑的な見方も強い。

 記事本文に具体的な数字・金額の記載なし

 Elon Musk, Tesla, SpaceX, TSMC, TeraFab

【Layer 4 | 地政学と巨大資本】


★★★ TSMC産業スパイ事件、来月判決へ——元エンジニアが2nm技術情報窃取で最大20年の禁固刑に直面


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-industrial-espionage-saga-heading-to-verdict-next-month-in-unprecedented-taiwan-national-security-act-case-former-engineer-accused-of-stealing-2nm-technical-info-faces-a-total-of-up-to-20-years-in-prison-if-found-guilty>

台湾TSMCの元エンジニアが2nmプロセス技術の機密情報を窃取したとして、台湾国家安全法違反で起訴された産業スパイ事件が来月判決を迎える。同法適用としては前例のない重大ケースであり、有罪となれば最大20年の禁固刑が科される可能性がある。TSMCの最先端プロセス技術の保護と経済安全保障の観点から、半導体業界および国際社会から注目を集めている。

 最大20年の禁固刑、2nmプロセス技術

 TSMC, 台湾, 台湾国家安全法


★★★ 中国半導体業界リーダー、AIデータセンター用チップで5～10年の遅れを認める


出典: Tom's Hardware | 2026-03-30

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/chinese-chip-industry-leaders-say-ai-demand-is-straining-equipment-and-talent-supply>

中国の半導体業界幹部らが、AIデータセンター向けチップにおいて中国は先進国に対して5~10年の遅れがあると公式に認めた。AI需要の急拡大により製造装置および技術人材の供給が逼迫しており、中国国内の半導体エコシステム構築における深刻な課題が浮き彫りとなっている。制裁による先端装置の調達制限と国内育成の加速が急務となっている。

 5~10年(技術格差の推定年数)

 中国, Tom's Hardware

■ 2026年04月01日 のニュース

【Layer 2 | アーキテクチャとAI設計】


★☆☆ Nvidia 3D Vision 2メガネが2.99ドルで発見——2011年の遺物、かつて149ドルの高級品

出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/peripherals/gaming-headsets/pc-enthusiast-finds-relic-nvidia-3d-vision-2-glasses-for-usd2-99-pc-gaming-artifact-from-2011-cost-usd149-new-was-once-the-future-of-gaming>

あるPCゲーム愛好家が、2011年にNvidiaが発売した3D Vision 2メガネを2.99ドルで入手した。当時149ドルで販売されていたこの製品は、Nvidiaが次世代ゲーム体験として推進した立体視技術の象徴だった。しかし3D映像技術はコンシューマー市場で普及せず、Nvidiaは2019年に同技術のサポートを終了。現在はほぼ価値のない骨董品となっており、技術トレンドの盛衰を象徴するエピソードとして紹介されている。

 発売価格149ドル、中古入手価格2.99ドル、発売年2011年、サポート終了2019年

 Nvidia


★★☆ NvidiaのDLSS 4.5 動的マルチフレーム生成、5倍・6倍の新マルチプライヤーをハンズオンレビュー


出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/we-go-hands-on-with-nvidias-dlss-4-5-dynamic-multi-frame-generation-and-its-5x-and-6x-multipliers-more-generated-frames-now-tailor-made-for-your-monitors-refresh-rate>

NvidiaがDLSS 4.5に新機能「Dynamic Multi Frame Generation(動的MFG)」を導入。従来のフレーム生成技術を進化させ、5倍・6倍のフレームマルチプライヤーを実現。モニターのリフレッシュレートに最適化された生成フレーム数を動的に調整する仕組みで、AIを活用したレンダリング効率の大幅な向上を図る。Tom's Hardwareが実機検証を実施。

 フレームマルチプライヤー5倍・6倍、DLSS 4.5

 Nvidia


★★☆ NvidiaのDLSS 4.5がベータ公開、RTX 50シリーズ向けに5X・6Xフレーム生成モードを追加

出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-dlss-4-5-dynamic-mfg-plus-5x-and-6x-framegen-modes-enter-beta-for-rtx-50-series-users-update-offers-greater-control-over-generated-frame-rates-and-more-headroom-for-high-refresh-rate-displays>

NvidiaはDLSS 4.5のベータ版をRTX 50シリーズユーザー向けに公開した。新機能「Dynamic MFG(マルチフレーム生成)」に加え、5X・6Xフレーム生成モードを導入。これにより高リフレッシュレートディスプレイ向けのヘッドルームが拡大し、ユーザーは生成フレームレートをより細かく制御できるようになった。AIを活用したフレーム補間技術のさらなる進化を示す。

 5X・6Xフレーム生成モード、DLSS 4.5

 Nvidia


★★☆ IntelのiBOT技術でGeekbenchスコアが最大30%向上、ベクトル命令の最適化が要因

出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/geekbench-investigates-up-to-30-percent-jump-with-intels-ibot-performance-gain-attributed-to-newly-vectorized-instructions>

IntelのCore Ultra 7 270K搭載CPUにおいて、「iBOT」と呼ばれる技術によりGeekbenchベンチマークスコアが最大30%向上することが確認された。この性能向上は新たにベクトル化された命令セットの最適化によるものとされる。GeekbenchはこのiBOTによるパフォーマンスゲインを調査中であり、ベンチマーク結果の妥当性評価が焦点となっている。

 最大30%のパフォーマンス向上、Core Ultra 7 270K

 Intel, Geekbench

【Layer 3 | 物理的資源とインフラ】


★★☆ オラクル、AI投資資金捻出のため1万人規模の大規模レイオフを実施


出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/oracle-believed-to-have-cut-10-000-positions-across-multiple-divisions-as-mass-layoffs-begin-company-is-reportedly-reducing-headcount-as-it-makes-massive-investments-in-ai>

オラクルが複数部門にわたり約1万人の人員削減を実施していると報じられている。この大規模なレイオフの目的は、AIインフラへの投資資金を確保するためとされており、特にデータセンターの建設・拡張に充てる方針とみられる。テクノロジー大手が人件費を削減してAI・クラウドインフラ投資へリソースをシフトする業界トレンドを反映した動きであり、半導体・データセンター需要に対する強気姿勢を示している。

 削減人数: 約1万人

 Oracle


★★★ 世界的ヘリウム供給危機が半導体製造サプライチェーンを直撃

出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/the-global-helium-shortage-is-a-direct-threat-to-chipmaking>

世界のヘリウム貯蔵量の減少が半導体製造サプライチェーンに深刻な脅威をもたらしている。ヘリウムはリソグラフィ装置の冷却、ウェーハ製造プロセス、大容量HDDの製造など半導体産業の重要工程に不可欠な素材。カタールのRas Laffanを含む主要供給源への依存が高く、代替供給源の開発も遅延が続いており、供給途絶リスクが業界全体に波及する懸念が高まっている。

 特定の数値情報は記事本文に記載なし

 QatarEnergy, Ras Laffan, カタール

【Layer 4 | 地政学と巨大資本】

★★★ OpenAIが1220億ドルの巨大資金調達、評価額8520億ドルに

出典: TechCrunch | 2026-03-31

URL:

<https://techcrunch.com/2026/03/31/openai-not-yet-public-raises-3b-from-retail-investors-in-monster-122b-fund-raise/>

OpenAIはAmazon、Nvidia、SoftBankが主導する資金調達ラウンドで総額1220億ドルを調達し、企業評価額が8520億ドルに達した。小口投資家からも30億ドルを調達しており、IPOに向けた準備が進んでいる。NvidiaがAI企業への巨大資本投下に関与することで、半導体需要の持続的拡大と業界内のパワーバランス変化が示唆される。

 総調達額1220億ドル、評価額8520億ドル、小口投資家からの調達30億ドル

 OpenAI, Amazon, Nvidia, SoftBank


★★★ イランがNvidiaやMicrosoft等17社の米国テック企業に施設破壊を脅迫

出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/iran-issues-direct-strike-threat-to-nvidia-microsoft-apple-google-14-other-us-tech-companies-these-companies-should-expect-destruction-of-their-facilities-in-response-to-each-act-of-terror-in-iran>

イランがNvidia、Microsoft、Apple、Googleを含む17社の米国テクノロジー企業に対し、「イランへの各テロ行為に対する報復として施設破壊を予告する」と直接的な攻撃脅威を発した。これは米国とイランの地政学的緊張を背景に、半導体・テック企業のインフラやサプライチェーンへの安全保障リスクが高まっていることを示す重大な警告であり、企業の事業継続計画や地政学的リスク管理に影響を与える可能性がある。

 対象企業17社

 イラン, Nvidia, Microsoft, Apple, Google, 米国


★★★ 富士通、Rapidusと連携し国産1.4nm AIチップ開発計画

出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/fujitsu-plans-dedicated-1-4nm-ai-chip-manufactured-entirely-in-japan-by-rapidus>

富士通はRapidusが製造する1.4nmプロセスを用いたAIチップを国内で設計・製造する計画を発表した。設計から製造まで完全に日本国内で完結させる方針で、日本の半導体自立化戦略の一環。RapidusはTSMCに対抗すべく最先端プロセス技術の国産化を目指しており、富士通との連携はその具体的な需要創出として重要な意味を持つ。

 1.4nm(製造プロセスノード)

 富士通, Rapidus, 日本

【Layer 5 | 市場再編と国家連合】

☆☆☆ CorsairとSamsung製品のバンドル特価: 白基調PCビルド向けセット611ドル

出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/pay-usd611-for-64gb-of-corsair-vengeance-r-ram-and-samsungs-2tb-pcie-gen-5-9100-pro-when-paired-with-a-gigabyte-x870-auros-elite-motherboard-and-corsair-frame-5000d-case-matching-colors-for-a-pure-white-build>

Tom's HardwareのTech Deals記事。Corsair Vengeance 64GB RAM、Samsung 2TB PCIe Gen 5 9100 Pro SSD、Gigabyte X870 Aorus Eliteマザーボード、Corsair 5000Dケースをセットで611ドルで提供するバンドルセール情報。白色統一デザインのPCビルドを想定した製品組み合わせ。半導体製品の小売価格動向を示す消費者向けコンテンツ。

 611ドル(バンドル価格)、64GB(RAM容量)、2TB(SSD容量)、PCIe Gen 5

 Corsair, Samsung, Gigabyte, Tom's Hardware


★★★ NvidiaがMarvellに20億ドル投資、NVLink Fusion提携を強化


出典: Tom's Hardware | 2026-03-31

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/nvidia-invests-2-billion-in-marvell-to-deepen-nv-link-fusion-partnership>

NvidiaはMarvellに対して20億ドルの投資を行い、NVLink Fusionパートナーシップを深化させる契約を締結した。MarvellはNvidiaの競合企業の一つでもあるにもかかわらず、両社はカスタムAIチップ向けの相互接続技術で協力関係を構築する。この動きはNvidiaのエコシステム拡張戦略の一環であり、NVLinkを業界標準の相互接続規格として普及させる狙いがある。

 20億ドル(NvidiaによるMarvellへの投資額)

 Nvidia, Marvell

■ 2026年04月02日 のニュース

【Layer 2 | アーキテクチャとAI設計】

★★★ CognichipがAIによるチップ設計に6000万ドル調達


出典: TechCrunch | 2026-04-01

URL:

<https://techcrunch.com/2026/04/01/cognichip-wants-ai-to-design-the-chips-that-power-ai-and-just-raised-60m-to-try/>

スタートアップのCognichipは、AIを活用して半導体チップの設計を自動化・効率化するプラットフォームを開発しており、6000万ドルの資金調達に成功した。同社はチップ開発コストを75%以上削減し、開発期間を半分以上短縮できると主張している。AIが次世代AIチップの設計を担うと

いう「AIによるAIのための設計」という革新的アプローチで、半導体EDA(電子設計自動化)市場に新たな変革をもたらす可能性がある。

 調達額6000万ドル、開発コスト75%以上削減、開発期間50%以上短縮

 Cognichip

★☆☆ Neweggで490ドルのお得なセット: AMD Ryzen 5 9600X、DDR5メモリ、マザーボード、水冷クーラーが500ドル以下


出典: Tom's Hardware | 2026-04-02

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/amazing-usd490-newegg-combo-includes-a-n-amd-ryzen-5-9600x-cpu-16gb-of-g-skill-ddr5-6000-ram-msi-pro-b850-s-motherboard-and-240mm-msi-mag-coreliquid-a13-aio-cpu-cooler-all-for-under-usd500>

Neweggにて、AMD Ryzen 5 9600X CPU、G.Skill DDR5-6000 16GBメモリ、MSI Pro B850-Sマザーボード、MSI MAG Coreliquid A13 240mm水冷クーラーをセットで490ドル以下で販売するお得なコンボ商品が登場。コストパフォーマンスを重視するPC自作ユーザー向けの注目セットとして紹介されている。

 490ドル(セット価格)、DDR5-6000、16GB、240mm

 AMD, G.Skill, MSI, Newegg


★☆☆ 損傷したRTX 4090をジャンパー線とカスタムBIOSで復活、VRAM4GB減で延命成功


出典: Tom's Hardware | 2026-04-02

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/modders-use-jumper-wires-and-a-custom-bios-to-save-a-damaged-rtx-4090-from-the-trash-resurrected-nvidia-gaming-gpu-loses-4gb-of-vram-to-overcome-terminal-pcb-sagging>

破損したNvidia RTX 4090グラフィックカードを、改造者たちがジャンパー線とカスタムBIOSを用いて修復した事例。PCB(基板)の深刻なたわみによる物理的損傷を抱えた本来廃棄予定のGPUを、VRAMを4GB削減することで動作可能な状態に復活させた。半導体チップ自体ではなく基板レベルの修復・ハック技術による延命措置であり、ハイエンドGPUの修理可能性やコミュニティ主導のハードウェア改造文化を示す事例。

 VRAM 4GB削減(24GB→20GB相当)

 Nvidia, RTX 4090


★☆☆ AMD Ryzen 5 7600X3D が100ドル引きの246ドルでAmazon販売中

出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/save-usd100-on-the-gaming-powerhouse-a-md-ryzen-5-7600x3d-now-usd246-on-amazon-budget-friendly-x3d-processor-with-96mb-cache-low-power-draw-and-excellent-gaming-performance>

AMD Ryzen 5 7600X3DがAmazonで246ドル(約100ドル値引き)で販売中。96MBの3D V-Cacheを搭載し、低消費電力ながら優れたゲーミング性能を発揮するバジェット向けX3DプロセッサのセールをTom's Hardwareが紹介。ゲーマー向けのコストパフォーマンス重視の購買機会として取り上げた製品ディール記事。

 価格246ドル、100ドル値引き、96MBキャッシュ(3D V-Cache)

 AMD, Amazon


★★★ NvidiaアプリにAuto Shader Compilation機能追加——ドライバー更新後の自動バックグラウンドコンパイルでゲームロード時間を短縮

出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/gpu-drivers/nvidia-app-adds-auto-shader-compilation-for-faster-load-times-in-games-beta-feature-automatically-recompiles-shaders-in-the-background-after-every-driver-update>

NvidiaはNvidiaアプリにベータ機能「Auto Shader Compilation」を追加した。この機能はドライバー更新のたびにシェーダーをバックグラウンドで自動再コンパイルし、ゲームの初回ロード時間を短縮する。従来はゲーム起動時にシェーダーコンパイルが発生し、スタッタリングや長い待機時間の原因となっていたが、本機能により事前処理することでゲームプレイ体験の向上を図る。

 特記なし

 Nvidia

【Layer 3 | 物理的資源とインフラ】


★★★ MetaのAIデータセンター「Hyperion」、10基の天然ガス発電所で稼働へ

出典: TechCrunch | 2026-04-01

URL:

<https://techcrunch.com/2026/04/01/metas-natural-gas-binge-could-power-south-dakota/>

Metaが建設予定の大規模AIデータセンター「Hyperion」の電力供給のため、新たに10基の天然ガス発電所を整備することが明らかになった。AIインフラの急拡大に伴う電力需要の爆発的増大を背景に、再生可能エネルギーだけでは需要を賄いきれないとして化石燃料への依存が進んでいる実態が浮き彫りになった。サウスダコタ州全体の電力消費に匹敵するとも言われる規模であり、AI開発競争が電力インフラ整備に与える影響の大きさを示している。

 天然ガス発電所10基新設、電力規模はサウスダコタ州全体相当

 Meta, Hyperion, サウスダコタ州


★★☆ PCメーカー、メモリ・CPU以外の部品コストも急騰——PCB・プラスチック材料など広範に波及

出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/pc-makers-report-surgingly-increasing-prices-across-different-components-increasing-costs-are-going-beyond-memory-chip-and-processors-now-affecting-pcbs-plastic-materials-and-more>

PCメーカー各社がメモリチップやプロセッサにとどまらず、プリント基板(PCB)やプラスチック材料など幅広い部品のコスト上昇を報告している。半導体関連部品だけでなくサプライチェーン全体にわたるコスト増が顕在化しており、PC製造コストへの圧力が高まっている。Frameworkなど各メーカーの製品価格や調達戦略にも影響が及ぶ可能性がある。

 特定の数値データは記事本文に記載なし

 Framework, Tom's Hardware

【Layer 4 | 地政学と巨大資本】


★★★ ArmがAGI CPU「Kleidia」を中国市場でも販売へ

出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/arm-to-sell-its-new-agi-cpu-in-china-we-would-expect-the-demand-for-this-product-to-be-just-as-strong-in-china-as-it-is-in-the-rest-of-the-world>

Armは新世代のAGI向けCPU「Kleidia」を中国市場でも販売する方針を明らかにした。同社CEOはレネ・ハースは「中国での需要は世界他地域と同様に強いと見込んでいる」と述べた。米国の輸出規制が厳しさを増す中、ArmはCPU設計(ソフトウェア関連技術)が輸出規制の対象外であるとの立場を維持しており、中国市場へのアクセスを継続する戦略をとっている。

 特記なし

 Arm, Rene Haas, 中国, 米国

【Layer 5 | 市場再編と国家連合】


★★★ インテル、アイルランドFab合併会社の49%株式を買い戻しFab 34の完全支配権を取得


出典: Tom's Hardware | 2026-04-02

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/intel-buys-back-49-percent-stake-in-ireland-fab-jv-gains-full-control-over-fab-34>

インテルはアイルランドのFab 34における合併会社の49%持分を買い戻し、同施設の完全支配権を取得した。Fab 34はIntel 4プロセスノードを用いた先端ロジック製造拠点であり、欧州における半導体製造能力の中核を担う。今回の買い戻しにより、インテルは製造戦略の自律性を高め、ファウンドリ事業再編の一環として生産体制を強化する狙いがあるとみられる。

 49%(買い戻し持分比率)

 Intel, アイルランド, Fab 34

★★★ NvidiaがMarvellに20億ドル投資——NVLink Fusionでソフトなエコシステム囲い込みを実現

出典: Tom's Hardware | 2026-04-02

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/nvidia-invests-2-billion-in-marvell-whose-biggest-clients-are-trying-to-replace-nvidia-chips>

NvidiaはAI向けASIC競合であるMarvellに約20億ドルを投じ、NVLink Fusionを通じてカスタムAIチップとNvidiaのインターコネクト技術を統合する戦略を展開。これにより競合チップメーカーを直接支援しつつも、NVLinkという接続規格への依存を通じてエコシステムの囲い込みを図る。ハードな排除ではなくソフトな標準支配によって業界のパワーバランスを掌握する新たなプラットフォーム戦略とみられる。

 20億ドル(約2 billion USD)の投資額

 Nvidia, Marvell, NVLink Fusion


★★★ 2025年世界半導体ファウンドリ市場が3200億ドルの過去最高を記録、TSMCがさらにリード拡大

出典: Tom's Hardware | 2026-04-02

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/global-semiconductor-foundry-market-hit-a-record-320-billion-in-2025>

2025年の世界半導体ファウンドリ市場は3200億ドルの過去最高を達成した。TSMCは市場シェアをさらに拡大し、競合他社との差を広げた。AI向け半導体需要の急増が市場成長を牽引したとみられ、ファウンドリ業界全体のパワーバランスにおいてTSMCの支配的地位がより鮮明になった。

 市場規模3200億ドル(2025年過去最高)

 TSMC, 台湾


★★★ 中国でのNvidiaシェアが60%未満に低下、中国製AIチップが165万個供給


出典: Tom's Hardware | 2026-04-01

URL:

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/nvidia-market-share-in-china-falls-to-less-than-60-percent-chinese-chip-makers-deliver-1-65-million-ai-gpus-as-the-government-pushes-data-centers-to-use-domestic-chips>

中国政府がデータセンターに国産チップの使用を促進する政策を推進する中、Nvidiaの中国市場シェアが60%を下回った。中国のチップメーカーは165万個のAI GPUを供給しており、HuaweiなどのDomesticベンダーが急速にシェアを拡大している。米国の輸出規制によりNvidiaの高性能チップ販売が制限される中、中国国内メーカーへの代替が加速している状況を示している。

 Nvidiaの中国市場シェア60%未満、中国製AI GPU供給数165万個

 Nvidia, 中国政府, Huawei, 中国チップメーカー